

证券代码：301389

证券简称：隆扬电子

隆扬电子（昆山）股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2026-001

活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他 _____
参与单位名称	天弘基金申宗航、哲云私募吴雅婷、东吴自营程颢、相聚资本李慧丰、华宝信托张卿隆、长信基金陈宇哲、凯恩投资兰云池、国泰海通陈思靖、趣时资产冯珺、阳光天泓资产林永祥、信泰保险刘跃、东吴证券刘玥娇、解承堯 (以上排名不分先后)
时间	2026年2月26日
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	董事长 傅青炫 董事会秘书 金卫勤 证券事务代表 施翌
主要内容介绍	第一部分：公司介绍 上市公司介绍了基本情况、发展历程、核心业务、发展战略等。公司主要产品为电磁屏蔽材料及部分绝缘材料、散热材料，产品主要应用于3C消费电子行业及新能源汽车行业。同时，公司积极向铜箔材料在信号高频高速应用方向布局，目前积极推进铜箔材料的验证进程。 公司于2025年8月、9月分别完成了常州威斯双联及苏州德佑新材的两个并购项目，进一步增强公司材料自研体系的核心竞争力，实现优势互补与资源协同。 第二部分：上市公司解答提问

	<p>董事长同与会人员进行了问答交流，本次交流主要内容如下：</p> <p>Q1、公司并购的两家企业和公司的协同作用主要体现在哪些地方？</p> <p>两个并购标的与本公司隶属同一行业，具有显著的协同效应。通过本次收购，未来将优化供应链管理，有效降低公司生产成本。其次，两个标的公司均具备深厚的技术积累和创新能力，其研发团队将显著增强公司自研体系的核心竞争力，并且可提升公司新品研发效率，进一步加强公司国产替代的能力。最后，客户端的差异性可以促进各自的产品互通，客户互融，进一步拓展现有客户群体。在通过本次收购可实现优势互补与资源协同，同时亦将保持业务端的独立运营体系，以并行发展模式释放协同价值，推动业绩提升。</p> <p>Q2、公司 HVLP5 铜箔目前和客户的验证情况如何？</p> <p>公司目前有配合部分客户交付样品订单，尚未有批量化订单；产品尚在验证之中。</p> <p>Q3、公司对于未来铜箔材料投入如何考虑？</p> <p>铜箔事业作为公司双轮驱动的一个重要环节，公司对于铜箔事业的研发费用、人才引进、团队建设及资本开支，未来仍然会持续性发生及不断投入；但是公司会按照项目情况及产业进程具体实施。</p> <p>Q4、公司未来会在哪里建设铜箔工厂？</p> <p>公司第一个铜箔细胞工厂目前坐落于淮安，铜箔工厂未来主要会在江苏淮安及泰国地区。</p> <p>Q5、公司铜箔的核心优势是什么？和竞争对手的差异主要在哪里？</p> <p>公司铜箔产品主要具有低表面粗糙度及良好的结合力，和竞争对手的差异主要是工艺路线选择的不同。</p>
附件清单（如有）	无
关于本次活动是否涉及应披露重大信息的	公司严格按照《信息披露管理制度》等规定，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。没有出现未公开重大信

说明	息泄露等情况。
----	---------